

半導体製造装置事業の特徴

AIやIoTの普及に伴いデータ社会への移行が加速し、半導体が担う役割はますます重要になっています。デジタル技術の活用がさらに拡がり、半導体の技術革新が進む中、それを支える半導体製造装置の重要性もより一層高まっています。

半導体製造装置メーカーが継続的に事業を展開するためには、さまざまな領域の専門性を駆使し、最高の性能を備えた装置を開発することが極めて重要です。そのためには、お客さまとの確固たる信頼関係のもと早期にニーズを把握し、中長期視点での研究開発に取り組むとともに、最先端技術の創出に向けてコンソーシアムとの協働を進め、グローバルに研究開発を展開していく必要があります。そして、これらの活動を継続的かつ確実に実施するための設備投資と強固な経営・財務基盤が不可欠です。

また、装置の安定稼働を支える付加価値の高い技術サービスを提供していくことも重要です。そのために、AIの活用などデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進も積極的におこなわれています。

これらに加えて、部品・材料の供給、装置の組み立てや調整、通関・物流などに関わるさまざまなサプライヤーとのパートナーシップに基づくサステナブルなサプライチェーンの構築も欠かすことはできません。さらに高性能・低消費電力の半導体開発への貢献や製造装置の生産性向上、環境負荷低減への対応も半導体製造装置メーカーに求められています。

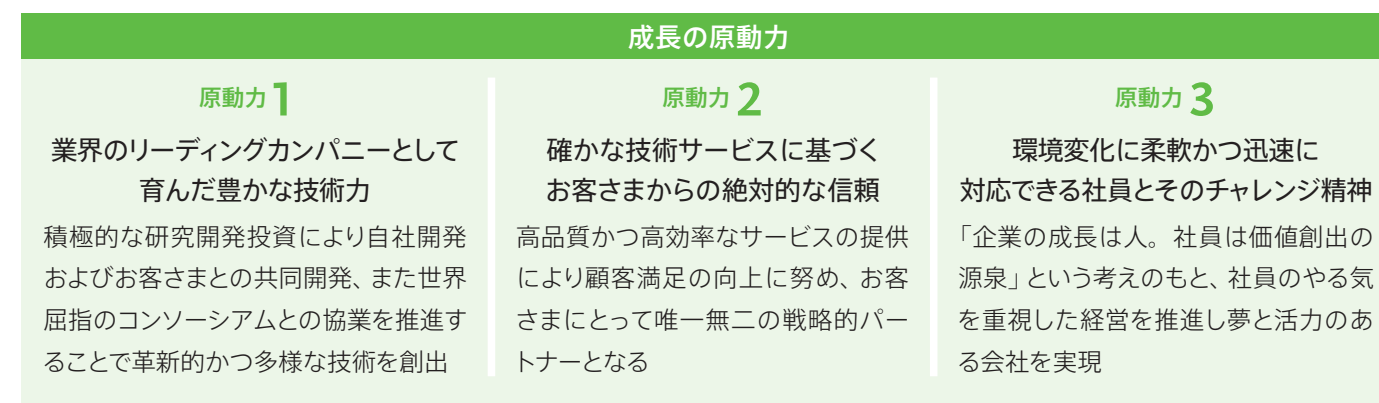
半導体の技術革新が製造装置市場の成長を牽引



成長の原動力と強み

当社は、創業時より大切にしているステークホルダーとの信用・信頼を礎に独自のビジネスモデルを展開するとともに、「業界のリーディングカンパニーとして育んだ豊かな技術力」や、「確かな技術サービスに基づくお客さまからの絶対的な信頼」、また「環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる社員とそのチャレ

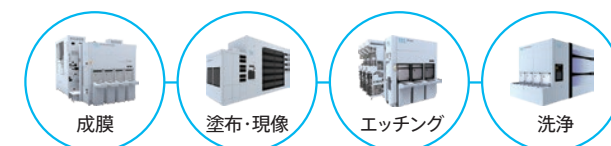
ンジ精神」を成長の原動力として培ってきました。これらの原動力により創出される強みを当社の事業活動における優位性として最大限に生かすことでさらなる成長を図り、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めています。



強み

Only one

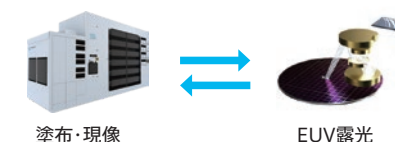
半導体の微細加工に必要な成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄という連続した4つのキープロセスに製品をもつ世界で唯一のメーカー



100%

半導体の進化に必要なEUV※1露光用の塗布現像装置のシェアが100%

※1 EUV: Extreme Ultraviolet。半導体業界では特定の波長13.5nmを使用した露光技術の総称



No.1 / No.2

当社の製品群は各セグメントで強いポジションにあり、いずれも市場シェア※2 1位もしくは2位を獲得

※2 当社推定（2023年）

※3 各セグメントにおける当社の製品群：拡散炉※3、パッチ成膜はALD（Atomic Layer Deposition）とCVD（Chemical Vapor Deposition）、メタル成膜は枚葉成膜、洗浄は枚葉洗浄とパッチ洗浄をそれぞれ含む



No.1

世界最大の出荷実績を通じて培ったお客さまとの絶対的信頼関係のもと展開する技術サービスとマーケティング

※4 2024年3月末時点

世界装置出荷台数（累計）業界最大の約92,000台※4
年間約4,000~6,000台※4ずつ増加

No.1

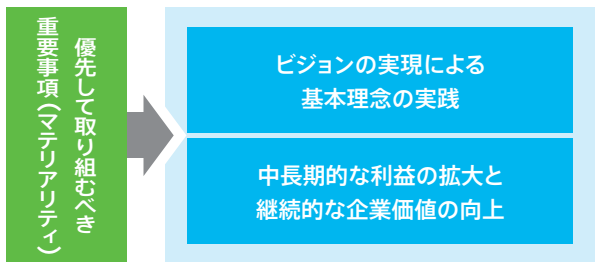
特許保有件数が半導体製造装置業界においてグローバルNo. 1

※5 2024年3月末時点。LexisNexis®PatentSight®データに基づき作成



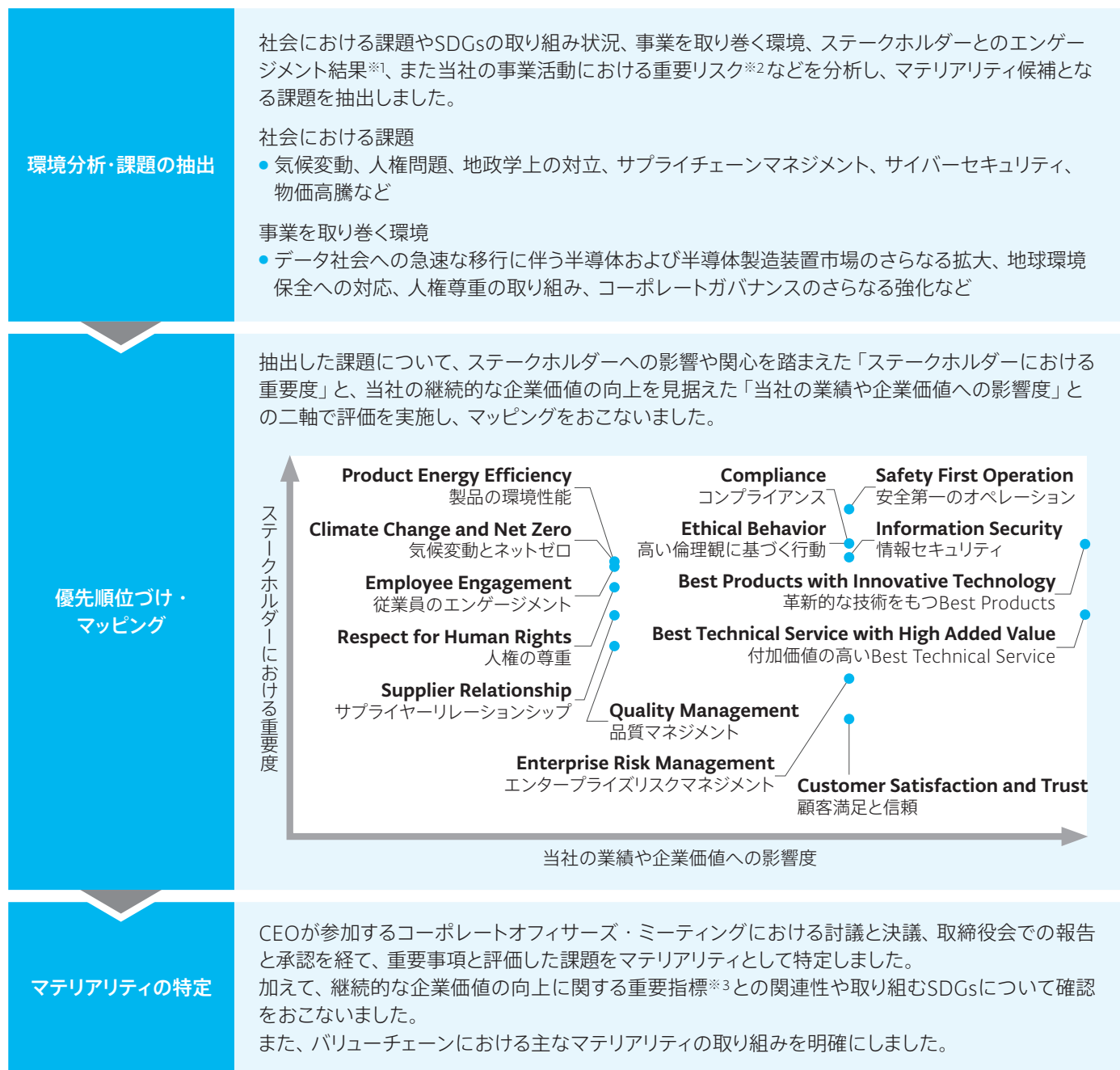
マテリアリティ

当社はビジョンの実現による基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指す上で、優先して取り組む重要事項をマテリアリティとして位置づけ、毎年見直しをおこなっています。2024年3月期には以下の特定プロセスに沿って、既存のマテリアリティをより細分化した内容に見直し、新たにマテリアリティを特定しました。



マテリアリティの特定プロセス

マテリアリティの特定にあたり、そのプロセスの検討については第三者である専門家の助言を受けています。



※1 [ステークホルダーエンゲージメント P.25-26](#) ※2 [リスクマネジメント P.75-76](#) ※3 [継続的な企業価値の向上に関する重要指標 P.17-20](#)

特定したマテリアリティ

マテリアリティ	マテリアリティの意義		取り組むSDGs
	当社における意義	社会における意義	
 Climate Change and Net Zero 気候変動とネットゼロ	ネットゼロの達成に向けた事業や製品・サービスにおける環境負荷の低減	気候変動リスクの低減と新たな機会の創出	 
 Product Energy Efficiency 製品の環境性能	製品の環境性能強化およびプロセス性能との両立	環境に配慮した製品の提供による地球環境の保全	 
 Best Products with Innovative Technology 革新的な技術をもつBest Products	革新的な技術をもつ付加価値の高い製品の創出による優位性の確立	半導体の進化によるイノベーションの促進と社会の発展	 
 Best Technical Service with High Added Value 付加価値の高いBest Technical Service	お客さまの課題を解決する高度なフィールドソリューションの提供により事業機会を拡大	半導体デバイスの歩留まり向上と装置稼働率の最大化	 
 Customer Satisfaction and Trust 顧客満足と信頼	唯一無二の戦略的パートナーとして顧客満足を追求め絶対的な信頼関係を構築	投資対効果の最大化や共創による相互利益の拡大	 
 Supplier Relationship サプライヤー・リレーションシップ	開発や改善、品質向上などの活動を協業により推進	サプライチェーン全体における健全性の維持や競争力の強化	 
 Respect for Human Rights 人権の尊重	事業活動における人権リスクの低減と個人の尊厳の尊重	差別や不平等、労働や安全などの課題の解決	 
 Employee Engagement 従業員のエンゲージメント	個人が能力を最大限に発揮しいきいきと活動ができる環境の構築	ステークホルダーに有益なさまざまな価値を提供	
 Safety First Operation 安全第一のオペレーション	安全を最優先とすることで持続的なオペレーションを実現	安全な社会の構築	
 Quality Management 品質マネジメント	品質優先のオペレーションによる経営効率の追求	品質向上による競争力の強化と新たな価値の創出	
 Compliance コンプライアンス	企業の信頼性と持続的な成長の基盤として法令や規制および業界行動規範などの遵守	コンプライアンス意識の向上やコンプライアンス文化の醸成	
 Ethical Behavior 高い倫理観に基づく行動	社会的責任を自覚し従業員が誇りと幸せを感じることが出来る企業を目指す	公正で秩序のある社会の形成	
 Information Security 情報セキュリティ	サイバー攻撃や情報漏洩などへの対応によりデータの活用と情報セキュリティの両立	利便性を損なうことなく情報の安全性を確保	
 Enterprise Risk Management エンタープライズリスクマネジメント	事業上のリスクやその影響について適切に対応することで持続的な成長を図る	産業や社会の中長期的な発展に貢献	 

中期経営計画

当社は「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念のもと、技術革新のスピードが速いエレクトロニクス産業の中で半導体製造装置のリーディングカンパニーとしてビジネスを積極的に展開しています。

財務目標

中期経営計画においては将来の成長に向けて、ワールドクラスの営業利益率とROE（自己資本利益率）のさらなる向上を目指し2027年3月期をターゲットとした財務目標を設定しました。半導体の重要性が一段と高まり、半導体製造装置市場が今後も大きく成長し続けることが予想される中、バリューチェーンにおけるマテリアリティを軸としたさまざまな取り組みを進めるとともに、Best Products、Best Technical Service

主な取り組み※1

- 当社が得意とする分野や蓄積された技術、経営ノウハウが生きる分野でビジネスを展開
- 将来、お客さまが必要とする高付加価値のnext-generation productsをいち早く市場に投入し、最高水準の技術サービスを提供
- 2023年3月期からの5年間で1兆円以上の積極的な研究開発投資を実施
- 当社がこれまで出荷した業界最多となる約92,000台※2の装置をもとにパーツ販売やアップグレード改造、稼働率向上に取り組み、お客さまが生産するデバイスの歩留まり向上などの課題解決に努めるとともに、これらの高度なフィールドソリューションの提供を通じてアフターマーケットにおける収益拡大を図る。また今後、累積100,000台以上となる出荷済

2023年3月期にはさらなる成長を目指して「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」という新たなビジョンを掲げるとともに、中期経営計画を発表し、その達成に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

を常に追求し、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。

	2024年3月期実績	財務目標 (達成時期: 2027年3月期)
売上高	1兆8,305億円	3兆円以上
営業利益率	24.9%	35%以上
ROE	21.8%	30%以上

- 装置のサポートに備え、遠隔保守サービスおよび装置の稼働データやAIを活用した予知保全など、高効率かつ高付加価値サービスの構築にも注力
- サプライチェーン全体における地球環境の保全を目指したE-COMPASSを展開。製品や事業所における環境への取り組みを強化すべく、2031年3月期までの中期環境目標とその達成に向けたロードマップを策定し、さまざまな活動を実施。また2040年※3までのネットゼロ達成に向けて、温室効果ガスの排出量実質ゼロを実現する取り組みを推進

※1 これらの取り組みに加え、さらなる高い利益の創出と企業価値の向上を目指し、2025年3月期以降の5年間の成長投資、人材投資を計画。
研究開発投資: 1.5兆円以上、設備投資: 7,000億円以上、人材採用: グローバルで10,000名の採用(5年累計)
※2 2024年3月末時点
※3 2023年12月にネットゼロの目標達成年を2050年から2040年に前倒し

ビジョン		半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社
短中長期の利益の拡大と継続的な企業価値の向上		
財務目標 (2027年3月期): 売上高 3兆円以上、営業利益率 35%以上、ROE 30%以上		

売上高	営業利益率	ROE
●SAM※4の拡大およびシェア向上 ●付加価値の高い次世代装置の継続的な創出 ●高度なフィールドソリューションの提供を通じてアフターマーケットにおける収益拡大 ●研究開発費の投入	●キャッシュ・フローの拡大 ●業務効率化、生産平準化および仕様・部品の標準化による生産性向上 ●社員エンゲージメントの向上 ●ワーク・ライフ・バランスの実現 ●安全性向上: TCIR 0.10以下	●資本効率の追求 適切なキャッシュアロケーションとバランスシート・マネジメント ●資産効率の追求 生産・スタートアップリードタイム短縮、適正在庫水準の追求、設備投資効率の向上

※4 SAM: Served Available Market

財務責任者メッセージ

当社はビジョンの実現と財務目標の達成に向けて、以下の戦略や政策を実践するとともに、資本市場との対話を通じて企業価値・株主価値の向上に寄与してまいります。



1 成長戦略

- 売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE30%以上を2027年3月期までに達成する中期財務目標を設定
- 前中期経営計画で達成した営業利益率（29.9%）、資産効率をさらに高め、キャッシュ・フローの拡大に努めることで、ROE向上など高い資本効率を追求
- 創出したキャッシュを社会の持続的な発展を支える半導体の技術革新を生み出すための成長投資、人材投資に活用

これらに加え、2025年3月期からの5カ年計画として、以下の内容を2024年2月に公表いたしました。今後もさらなる成長に向けたさまざまな取り組みを加速してまいります。

- 1.5兆円以上となる積極的な研究開発投資
- 研究開発および生産能力の拡大、生産性向上に向けた7,000億円以上の設備投資
- グローバルで累計10,000名の人材採用

2 財務戦略

- 事業拡大を見据えた運転資金の確保による経営の安定化
- 強固な財務体質の維持
- 適切なキャッシュアロケーション、バランスシート・マネジメントの追求

当社はこれまで半導体製造装置業界におけるリーディングカンパニーとして大きな成長を遂げてきました。今後も次の成長投資に向けてキャッシュを有効活用し、高い成長ポテンシャルをもつ分野でさらなる事業の拡大を追求することで、中長期的な企業価値の向上に努めていきます。そして中期財務目標の具現化に向けて、これをサポートする財務戦略を実行してまいります。

3 資本政策

- 自社の企業価値の的確な把握と株価や時価総額の評価
- 資本コストや資本収益性を意識した最適な資本構成の実現
- キャッシュ・フロー拡大に基づく継続的かつ積極的な株主還元の実行

近年の高い利益成長の実績と将来に向けたさらなる成長への期待を背景に、当社の時価総額は高い伸びを示しており、2024年3月末時点の時価総額は東京証券取引所プライム市場第3位となりました。また2024年3月末時点のPBR（株価純資産倍率）は10倍以上の水準となっております。同時に当社が掲げる積極的な株主還元方針、高水準の成長投資、経営戦略に基づく優秀な人材の確保および育成、お客さまやお取引先さまとの協業やその成果など、当社の企業価値が資本市場で評価された結果、純資産と比較して時価総額が大きく増加しました。

■時価総額の推移



4 株主還元策

- 株主さまへの配当については業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する連結配当性向50%を目処とする※
- 自己株式の取得については現状のキャッシュポジションや中長期的な成長投資資金、株価水準、総還元額の状況などに鑑み、機動的に実施

※ ただし1株当たりの年間配当金は50円を下回らないこととし、2期連続で当期純利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討

ワールドクラスの中期財務目標を達成し、高水準の配当と機動的な自己株式の取得による株主還元を通して株主価値を高めていきます。

今後もこれらの戦略や政策を確実に実行することにより、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めてまいります。

継続的な企業価値の向上に関する重要指標

中期経営計画において、財務およびサステナビリティに関する指標を「継続的な企業価値の向上に関する重要指標」として明確にしています。2024年3月期には、これらの重要指標と関連する主なマテリアリティを確認しました。

CEOが参加する四半期レビュー会議にて定期的に進捗状況やアクションプランの確認をおこない、各指標における責任者のもとさまざまな活動を展開しています。

対象分野		指標	達成時期	2024年3月期実績	今後の取り組み	関連する 主なマテリアリティ
財務		●売上高: 3兆円以上	2027年3月期	●1兆8,305億円	中期経営計画 P. 15-16	
		●営業利益率: 35%以上	2027年3月期	●24.9%		
		●ROE: 30%以上	2027年3月期	●21.8%		
研究開発		●5年間で1兆円以上の研究開発費の投入による付加価値の高い next-generation productsの継続的な創出	2027年3月期	●研究開発費 2,028億円 (2023年3月期からの累積3,940億円)	●持続的成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続 ●開発効率のKPI化とその運用 ●ITシステムの開発による開発リスクの可視化やシミュレーションの実施 ●最先端装置の導入やDXの実装などによる開発基盤のさらなる強化	
環境	事業所	●CO ₂ 総排出量: 70%削減 (2019年3月期比) ※ ※ 2025年3月期より目標変更 「CO ₂ 総排出量: 85%削減 (2019年3月期比)」	2031年3月期	●75%削減	●事業活動によるエネルギー使用量の見える化や省エネルギー化の推進 ●台湾、韓国、シンガポールにおける再生可能エネルギーの導入推進	
		●再生可能エネルギー使用比率: 100%	2031年3月期	●90%	●再生可能エネルギーの継続的な供給の確保や非化石証書購入の推進	
		●各事業所におけるエネルギー使用量 (原単位): 前期比1% 削減	每期	●11事業所中、2事業所において達成	●原単位とエネルギー使用量の連動について再確認	
		●各事業所における水使用量 (原単位): 各基準期水準を維持	每期	●13目標中、10目標において達成	●水使用量削減に関するさらなるアクションの立案と実施	
	物流	●モーダルシフトおよび共同配送のさらなる推進による物流全体 (自社配送分) の CO ₂ 排出量: 30%削減	2027年3月期	●18.4%削減	●モーダルシフトと共同配送の拡大やEV車の導入	
		●製品の木材梱包の使用比率を50%以下に削減 (半導体製造装置の梱包)	2024年3月期※ ※ 2025年3月期に延長	●通期77.6% (第4四半期73.6%)	●STW (Strong Triple Wall) 梱包の標準化とお客さまへのさらなる展開の推進 ●海運に対応できる強化柱入りSTWの導入	
	製品	●ウェーハ1枚当たりのCO ₂ 排出量: 55%削減 (2022年3月期比)※ ※ 2024年3月期中に「ウェーハ1枚当たりのCO ₂ 排出量: 30% 削減 (2019年3月期比)」から目標変更	2031年3月期	●24%削減	●装置の省エネルギーのさらなる推進	
社員	エンゲージメント	●エンゲージメント・サーベイのスコア: 継続的な改善 (前回比スコア上昇)、もしくは各地域における他社平均値を超えるスコアを達成	毎回	●2023年3月期に実施したサーベイ結果を解析するとともに、直接社員の声を聞きながら各社ごとに改善プランを実行 (2024年3月期はサーベイの実施はなし)	●各社の各組織におけるエンゲージメント課題に関する対策の実施を継続 ●グローバル共通の課題である「キャリア機会」に関する対策の検討および実施 (メンタリング、マネージャー向けコーチングトレーニングなど)	
		●社員の定着率※ 日本: 99% 海外: 業界平均以上 ※ 定年などによる退職は除く	每期	●日本: 98.8% ●海外: 業界平均以上 (95.8%)	●日本: 自己都合退職者の退職傾向や理由を分析し、対策を実施 中途社員に対する職場順応やオファー内容に沿った業務の遂行などのサポート強化 ●海外: 各社別に自己都合退職者の退職傾向や理由を分析し、対策を実施	
	キャリア	●一人ひとりが上長や周囲のサポートを実感し、自分の将来 (キャリアパス) をイメージしながらやりたいことにチャレンジし成長することで、会社の成長や社会のために価値創出できる環境を構築	2027年3月期	●自立的なキャリア形成の環境整備と支援 (組織内でのコミュニケーションの充実、動機づけ、キャリア機会の提供、キャリア教育の推進など) ●新任マネージャー教育 (教育期間を3倍に拡充)	●マネージャー向けワークショップの継続により、組織力向上の必要性を理解し行動変容を推進することについてのサポートを強化 ●外部機関と連携して、「開発エンジニアのスキル管理」と「キャリアパスの見える化」を3カ年で推進 ●シニアオープンジョブ※の条件検討と、中堅層、マネージャー層を対象としたキャリア教育の実施 ※ 当社グループにおける定年後再雇用の社員向けの社内公募制度	
	ワーク・ライフ・バランス	●有給休暇取得率 日本: ①80% ②90% 海外: 前期実績と同等以上	日本: ①2027年3月期 ②2031年3月期 海外: 每期	●日本: 80.6% ●海外: 69.0% (前期実績65.6%)	●休暇取得パターンの事例紹介など、主にマネージャー層を対象に有給休暇の取得促進に向けた啓発活動を実施	
	ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン	●女性管理職比率 日本: 5% グローバル: 8%	2027年3月期	●日本: 3.1% ●グローバル: 6.3%	●ポテンシャル人材に対し、外部研修や女性のネットワーク活用などの機会を提供 ●各社、各ビジネスユニットのKPIを設定	

対象分野	指標		達成時期	2024年3月期実績	今後の取り組み	関連する 主なマテリアリティ
サプライチェーン マネジメント	● サプライチェーンサステナビリティアセスメントの実施率※ ※ 2025年3月期より目標追加 「アセスメント結果に応じた改善活動の実施」	資材系: 調達額の85%以上 物流系: 通関関連業者100% 人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) 100%	毎期	● 資材系: 調達額の85%以上を達成 ● 物流系: 通関関連業者100%を達成 ● 人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) 100%を達成	● アセスメント調査を踏まえた課題の把握と是正に向けた計画の確実な実施	  
	● サプライチェーンBCPアセスメントの実施率※ ※ 2025年3月期より目標追加 「アセスメント結果に応じた改善活動の実施」	資材系: 調達額の85%以上	毎期	● 資材系: 調達額の85%以上を達成	● アセスメント調査を踏まえた課題の把握と是正に向けた計画の確実な実施	
安全	● TCIR※ 0.10以下 (業界グローバル1位) ※ TCIR: Total Case Incident Rate。労働時間20万時間当たりの人身事故発生率		2027年3月期	● TCIR 0.15	● 現場巡視の強化 ● エルゴノミクス傷害※の防止対策 ● 安全教育体制の整備 ● 事故分析の強化と事故分析に基づく本質安全設計への反映 ※ エルゴノミクス傷害: 人間が扱う機械や器具などが原因で疲れやストレスを感じ、業務に関連した筋骨格系障害を発症すること	 
コーポレートガバナンス	● 常に最適で実効性の高い取締役会と攻めの経営執行体制を構築し、取締役会の実効性評価や機関投資家などからの意見を踏まえた課題に継続的に取り組むことで、中長期的な企業価値向上と持続的成長に向けた強固なガバナンスを実現 1. 実効性の高い取締役会を目指して ● 監査役会設置会社: 社外取締役比率1/3 (女性2名)*、監査役を含めた自由闊達な議論 ● オフサイトミーティング: 中長期的な戦略・課題などの議論 (年2回) ● CEO 報告: 取締役会でCEO自ら重要な業務執行状況を報告 (毎取締役会) ● CEOミッション: 中期経営計画達成に向けたCEOミッションの共有 ● 代表取締役評価クローズドセッション: 代表取締役を除く取締役・監査役によるセッション (年1回) 2. 業務執行を支えるオペレーティングリズム ● コーポレートオフィサーズ・ミーティング: 執行側の最高意思決定機関 (月1回) ● CSS (Corporate Senior Staff) ミーティング: 全社業務執行のグローバル横断の連携 (年4回) ● 四半期レビュー会議: 中期経営計画の進捗をモニタリング (年4回) ※ 2025年3月期に「社外取締役比率1/3 (女性2名)」から「社外取締役比率過半数」に変更		毎期	1. 実効性の高い取締役会を目指して ● 監査役会設置会社として、社外取締役比率1/2 (6名中3名) を維持。 過半数も視野に、指名委員会での活動を継続 第61期定時株主総会に提案する取締役候補者は、社外取締役比率が過半数 (7名中4名) ● オフサイトミーティング2回 (8月、2月) ● 取締役会で原則毎回、CEOによる業務執行に関する重要事項を説明 ● CEOミッション: 取締役会メンバーと共有 ● 代表取締役評価に関するクローズドセッション: 2回 2. 業務執行を支えるオペレーティングリズム ● コーポレートオフィサーズ・ミーティング: 20回 ● CSSミーティング: 4回 ● 四半期レビュー会議: 4回	以下の事項に取り組み、定期的に進捗をレビューすることで、その実効性をさらに高めていく (取締役会の機能と役割) ● 持続的な成長という将来展望から逆算し、中長期視点での当社のありたい姿を取締役会およびオフサイトミーティングで共有し、取締役会が果たすべき機能・役割やガバナンス体制の在り方について継続的に議論していく ● 当社の企業価値向上につなげていく観点から、今後も取締役会のアジェンダ設定を適切におこない、中長期の成長戦略に対する目線合わせと戦略的な議論のさらなる充実を図る (執行体制のさらなる強化と後継者計画の加速) ● 従来のコーポレートオフィサーが本部長を兼務する体制を改め、新たにディビジョンオフィサー制度を導入。これにより、CEOと視座をともにするコーポレートオフィサーはより高度な経営課題に注力するとともに、次世代経営人材を中心に構成されるディビジョンオフィサーが各本部の業務執行を統括する体制とする	 
リスクマネジメント	● 強固な経営基盤を支える実効性の高いリスクマネジメント体制の構築とさらなる改善 ● 「Safety, Quality and Compliance. Our top priority. It's our pride.」の標語を掲げ、リスクマネジメントおよびコンプライアンス遵守を強化 本社コンプライアンス専任部署やチーフ・コンプライアンス・オフィサー、リージョナル・コンプライアンス・ヘッドを設置するとともに外部機関によるアセスメントの実施や教育を展開※ ● 執行側の最高意思決定機関であるコーポレートオフィサーズ・ミーティング、および取締役会への報告 (年2回) を通じて監督・モニタリングを実施 ● 当社グループ全体において適切な対策を確実に実施するため、リスクマネジメント委員会を中心に事業を遂行する上で想定されるリスク (2024年3月期は12項目のリスク) を特定し、各社の活動に展開 ● 安全・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する啓発活動を継続的に実施し、全役員・全社員一人ひとりの意識、および自律的かつ具体的な取り組みを人事評価に反映 ※ 2025年3月期に「本社コンプライアンス専任部署やチーフ・コンプライアンス・オフィサー、リージョナル・コンプライアンス・ヘッドを設置するとともに外部機関によるアセスメントの実施や教育を展開」から「東京エレクトロングループの最高コンプライアンス責任者であるチーフ・コンプライアンス・オフィサーと国内子会社および海外子会社のコンプライアンス担当責任者が緊密に連携し、重大インシデントの未然防止に向けた企業倫理・文化の継続的醸成およびコンプライアンス態勢確立」に変更		毎期	● GRCツール※を用いたグループ全社のリスクマネジメント活動の定着と実行 ● 昨今のビジネス環境を踏まえて継続的にリスク項目の見直しを実施し、2024年3月期は12のリスクを元にリスクマネジメント活動を実践 ● リスクマネジメント委員会の開催、およびグループ各社のさらなる体制の強化に向けて、個社ごとのリスクマネジメント委員会設置に向けた取り組みを実施 ● 倫理委員会、各社/現地法人との定期的な会議を通じたコンプライアンス組織体制の強化。外部機関によるコンプライアンスアセスメントの導入検討 ● 倫理・コンプライアンス・リスクマネジメント研修の継続実施 (新任グループリーダー・部長向け研修) ※ GRCツール: 企業活動に関連するGRC (Governance・Risk・Compliance) 対応を統合することで、多層化・複雑化した企業の管理機能と収集される管理情報を体系的に整理し、適時に経営の意思決定に寄与する仕組み	● グループ全社での実効性の高いリスクマネジメントPDCA体制の確立と、事業遂行において想定される重要なリスクの早期発見と対策の確実な実行 ● RBA監査および外部機関によるアセスメント結果を踏まえた必要なコンプライアンスプログラムの改善と推進 ● 当社グループ人材戦略を踏まえたリスクマネジメント・コンプライアンス教育研修の計画的な実行と見直し (主な対象はマネージャーおよび中途社員・新卒社員)	     

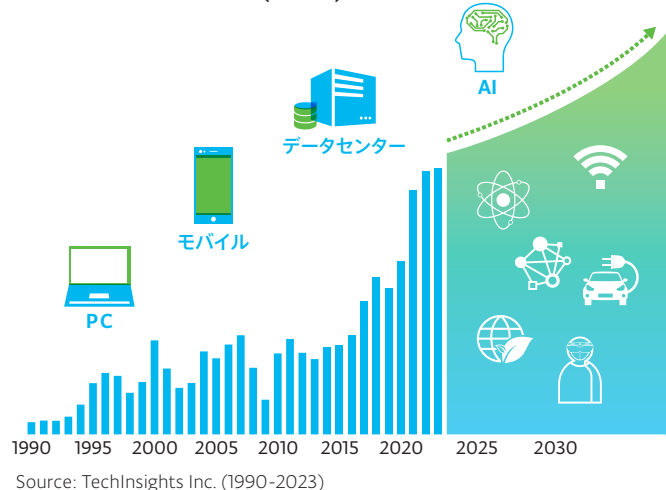
半導体製造装置事業の展望

2023年は半導体在庫の増加に加え世界的な半導体の調整が続きましたが、年後半には需給バランスが改善され、AI向けサーバーによる市場の成長やオンデバイスAIなどへの期待の高まりとともに、半導体産業の成長ポテンシャルが再認識されました。

今後、AIを中心としたさまざまなアプリケーションの拡大とともに、半導体市場および半導体製造装置市場はさらに成長していくことが期待されます。

※ WFE: Wafer Fab Equipment。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置のこと。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む

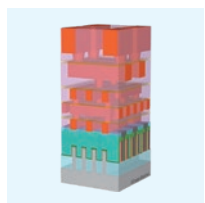
半導体前工程製造装置 (WFE※) 市場



半導体デバイステクノロジーの進化と事業機会

半導体市場や半導体製造装置市場のさらなる成長を支えるのは、半導体デバイスにおける技術革新です。ロジック、DRAM、NANDの各デバイスにおいては、さらなる微細化、高積層化によるトランジスタ性能の向上や記憶容量の拡大に加え、製造コストの低減や低消費電力化への要請が今後も高ま

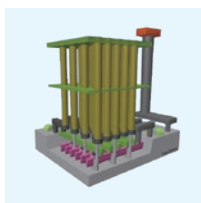
ロジック



最先端のロジックデバイスにおけるトランジスタ構造は、現在のFinFET※¹から新たな構造 (GAA NS※²、CFET※³) へ移行していきます。パターニングの複雑化や、さらなる微細化の実現に向けた高NA EUV※⁴リソグラフィ技術の量産への適用に伴い、ユニットプロセス間の相互最適化の必要性がより一層高まります。また、配線技術においては、Cuに代わる新規材料や、電源配線の抵抗を低減させる裏面配線の開発が進められています。当社の前工程向け装置やウェーハボンディング/デボンディング装置は、このような技術革新の実現に貢献します。

※¹ FinFET: Fin Field Effect Transistor。Fin (ヒレ) 状の3次元 (3D) 構造のプロセス技術
 ※² GAA NS: Gate All Around Nanosheet。FinFETの次世代技術
 ※³ CFET: Complementary Field Effect Transistor。新構造のトランジスタ
 ※⁴ 高NA EUV: 次世代EUVを指し、NA (Numerical Aperture。開口数) を上げることでより解像できる線幅を短くする露光技術

DRAM

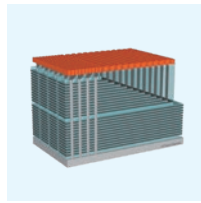


DRAMにおいては、高アスペクト比※¹のキャパシタとコンタクトを形成する技術の重要性がますます高まります。これらの技術には、当社の成膜、エッチング、洗浄装置が多く採用されています。今後、現在

の2次元 (2D) 配置から新しい2D配置への構造変化や、メモリセルを縦方向に積層した3D DRAMへの移行が予想される中、当社はこのような技術革新に貢献していくために、新たな製品やソリューションを継続的に提供していきます。また、AI向けの用途として、データ転送を広帯域におこなうことが可能なHBM※²の需要が高まっています。HBMはDRAMチップを積み上げて製造するため、ウェーハボンディング/デボンディング装置など、従来に比べてより多くのプロセスを実現していく装置が必要となります。当社はこのような最先端技術においてもお客さまと協働してプロセスをつくり上げ、それらをサポートすることで技術革新に貢献していきます。

※¹ アスペクト比: ウェーハ上に形成されたパターンの深さと幅の比
 ※² HBM: High Bandwidth Memory

NAND

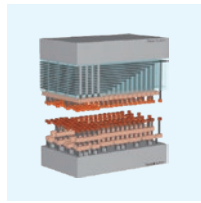


3D NANDの高積層化がさらに進み、今後500層、1,000層と積層数が増加していくことが予想されます。これに伴い、高アスペクト比の深い穴や溝の加工を実現するエッチング、犠牲膜の成膜と除去、

3D構造における原子レベルの成膜技術などが必要となります。メモリ容量の増加とともにデータ転送速度の高速化も求められており、その実現のためには周辺回路の性能向上が欠かせませんが、メモリセル形成時の熱工程により生じる性能やスケールにおける制約が問題となっています。これを解決するために、メモリセルと周辺回路を別々のウェーハで製造してボンディングする3Dインテグレーション技術の量産化に向けた開発がおこなわれており、またこれによりチップサイズの最適化も可能になります。当社は、これらの技術要求に応えるべく、エッチング装置やALD※装置、ウェーハボンディング/デボンディング装置のさらなる高性能化に努めています。

※ ALD: Atomic Layer Deposition

アドバンスドパッケージングと3Dインテグレーション



半導体の技術革新を実現していくにあたり、半導体の製造には大きく2つのアプローチがあります。1つは半導体の進化の代名詞でもある微細化で、チップ上での半導体の集積度を高めていくものです。

もう1つはアドバンスドパッケージングです。これはAI向けデバイスにおけるプロセッサとHBMの組み合わせなど、複数のチップや機能を1つのパッケージに集積する技術です。アドバンスドパッケージングはすでにさまざまなデバイスに適用されており、今後もその範囲はさらに広がっていくことが予想されます。当社は微細化向けのソリューション提供に加え、この技術におけるウェーハボンディングも重視しています。前工程におけるNANDやCMOSイメージセンサー、およびパッケージング工程におけるHBMなどに適用されるウェーハボンディングを用いた3Dインテグレーションにおいては、前工程全体で培った技術と経験を生かすとともに、ウェーハボンディング/デボンディング装置やレーザエッジトリミング装置の提供により、最先端デバイスやシステムレベルでの性能進化に貢献していきます。

Shift Left

当社は、製品開発プロセスの初期工程に、技術・人材・費用などのリソースを投じるShift Leftを重視し、お客さまと共創した技術ロードマップを実現するための各種技術の開発や、未来の複数世代を見据えた研究に取り組んでいます。

Shift Leftによる製品開発では、お客さまのご要望を早期に把握し、フィードバックで得られた情報を技術開発に反映させ

優位性の高い製品を提案することで、お客さまの製品デバイスの歩留まりと量産ライン装置稼働率の最大化に貢献しています。また、お客さまの工場や開発・研究所に早い段階で評価機を納入するオンサイトコラボレーションを推進し、技術開発から量産装置への反映までの早期化と開発効率の最大化を図っています。

開発体制のさらなる強化

当社は、将来の成長を見据え積極的な投資をおこない、開発体制のさらなる強化に努めています。これまで宮城技術革新センターや東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ



宮城技術革新センター
(2021年9月竣工)



東京エレクトロン
テクノロジーソリューションズ
穂坂事業所 新開発棟
(2023年7月竣工)



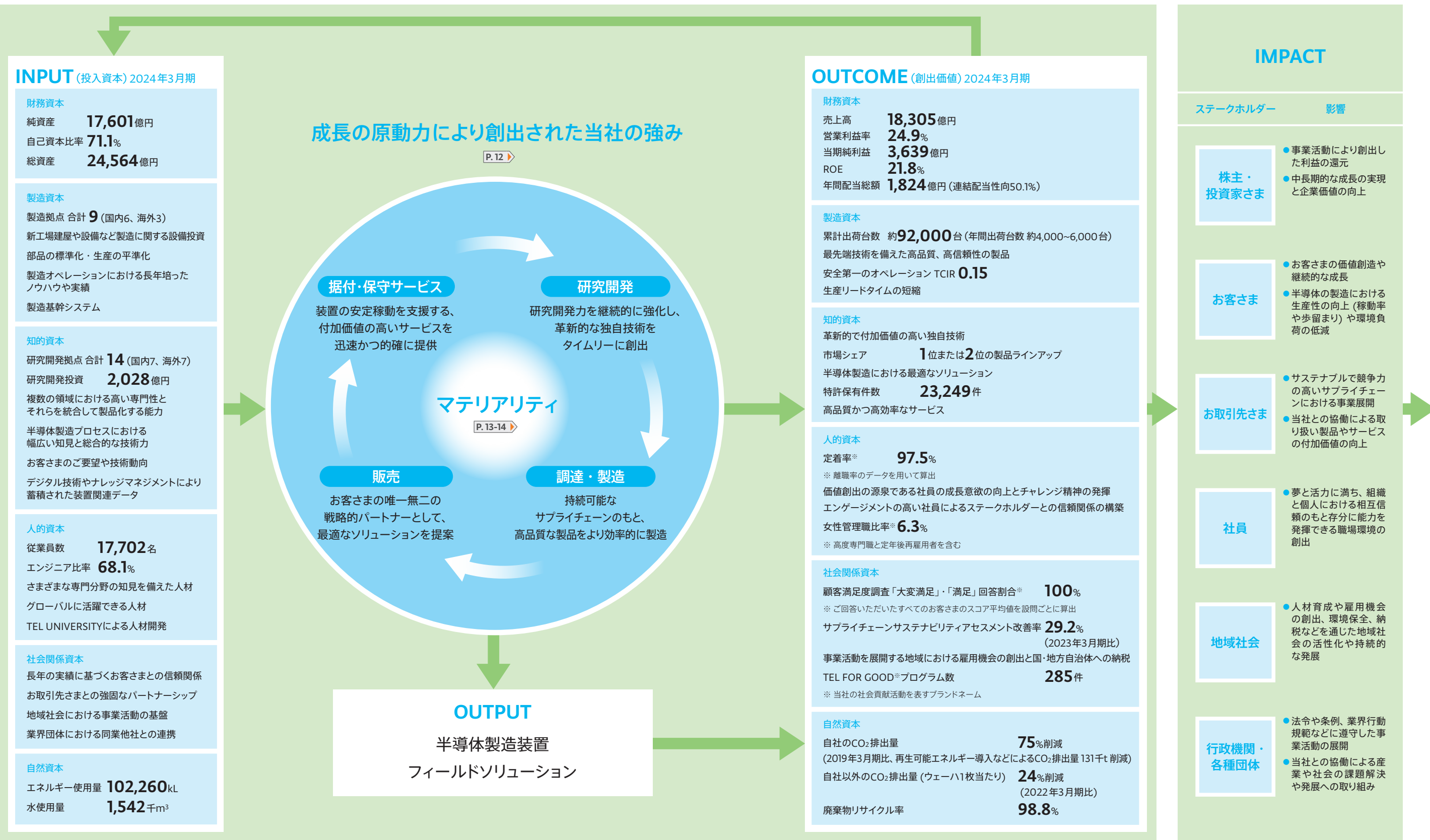
東京エレクトロン宮城
新開発棟
(2025年春竣工予定)



東京エレクトロン九州
新開発棟
(2025年夏竣工予定)

価値創造モデル

当社は保有する資本を最大限に活用し (INPUT)、強みを生かしながらマテリアリティを軸とした事業活動によるバリューチェーンを展開しています。これにより創出される価値 (OUTCOME) をステークホルダーに提供します。そしてビジョンの実現による基本理念の実践により中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指しています。



ステークホルダーエンゲージメント

当社では、ステークホルダーとの対話の機会を積極的に設け相互コミュニケーションを図ることにより、ステークホルダーからの要請や期待を的確に把握し事業活動を展開しています。社会における役割と責任を確実に果たしていくことで、当社を取り巻くすべてのステークホルダーとの確固たる信頼関係の構築に努めています。

